

洁盟 JM-ZK-300D 真空等离子清洗机技术规格



一、产品功能及特点

- 1、特殊处理及特殊结构的放电装置，确保形成稳定均匀的等离子体
- 2、高真空度真空腔体设计及制造工艺，拥有卓越的密封性
- 3、超低处理温度，满足不同场合温度要求，不对清洗产品造成热损伤和热氧化等问题
- 4、不分处理对象的基材类型,只要在此容量下的物件，均可进行处理,如金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等
- 5、安全保障，引入一键急停保护按钮，可以快速终止机器运转，降低因操作失误造成的对样品损害
- 6、可采用不同的气体介质进行处理（氧气、氮气、氩气、氢气或混合气体等气体），对材料最终的表面化学结构和性质有较好的可控性
- 7、自主研发的操作系统，精确控制试验时间、真空度、功率等重要参数，简洁智能
- 8、配置灵活，两种频率及功率任选，适用不同产品要求
- 9、高度自动化作业，减少人员干预，降低二次污染风险

二、产品技术参数

腔体容量	约 300L; W600mm*H600mm*D800mm
射频电源	1000W, 40kHz; 300W, 13.56MHz
电极层数	1-4 层可选
真空计	$1*10^{-2} \sim 1*10^5$
流量计	2-4 通道 MFC
极限真空度	20Pa 或更低



控制系统	10 寸 PLC 触摸屏（手动/自动）
工艺气体	氧气、氮气、氩气、氢气或混合气体
工艺气体接口	I.D 4mm, O.D 6mm
主机尺寸	W1500mm; H1800mm; D1350mm
配套附件	真空泵 1 台（可选干泵或者油泵），波纹管 1 条；
安装电源	380V/16A

三、应用场景

A、半导体

- 1、电子元件、PCB 清洗、IC 芯片、半导体硅片等表面清洁、活化增强绑定性等。
- 2、提高晶粒与焊盘导电胶的粘附性能、焊膏浸润性能、LED 封装。
- 3、等离子体清洗能有效去除键合区的表面污染物并使其粗糙程度增加，提高引线的键合拉力，极大的提高封装器件的可靠性

B、3C 数码

- 1、玻璃盖板：提高盖板表面活性、去静电、增加镀膜附着力
- 2、触摸屏：LCD/OLED/TP 贴合前，表面清洁活化
- 3、手机摄像头模组清洁，LENS/微马达（VCM）组装前清洗
- 4、PC 塑胶框粘接前处理；机壳、键盘、按键扭等结构件的表面喷油丝印处理等等

C、包装行业

- 1、专业提高覆膜纸、上光纸、磨光、金银卡、镀铝纸、UV\OPP\PP\PET 等彩盒、彩箱表面糊盒的牢固性
- 2、奶粉罐、饮料罐焊接前等离子预处理等
- 3、等离子清洗减少打磨污染，消除糊盒机的纸粉污染，节省耗材，节省胶水使用成本

D、印刷喷码

- 1、对塑料、金属、玻璃等复合材料表面移印、丝印、喷码前等离子预处理，提高材料表面对油墨的附着力。
- 2、PE\PTEE\硅橡胶电线电缆喷码前处理
- 3、PVC\PET\ABS 智能卡片喷码前预处理

E、塑胶橡胶

- 1、PP\PVC\PET\PC\PE\PTEE 等各类塑胶材料喷涂、印刷、电镀、粘接、和植绒的前处理，可防字脱落，粘接更牢固。
- 2、各种塑胶、硅胶、橡胶、金属等材料喷涂、印刷、电镀、粘接前表面改性、去除表面污染物
- 3、手机、电脑、玩具等塑料外科印字、喷漆前预处理，提高表面附着力。

F、家具家电

- 1、日用品、家电产品表面涂装、喷涂、粘接前等离子活化、提高产品表面附着力、接合力等
- 2、印字前处理，可使印字更牢固，不脱落
- 3、涂层前处理，使涂层更牢固